

2019 德國國際醫療展

MEDICA 2019



2019 Medica參展攤位更新!!!!

符合資格工業局補助2020印度孟買展

一、組團說明：

(一)承辦單位：財團法人金屬工業研究發展中心

(二)活動簡介：

■名稱：medica 2019

■官方網站連結：<https://www.medica-tradefair.com/>

■展覽日期：2019年11月18-21日

■展覽地點：Düsseldorf / Germany

■展會簡介：

全球規模最大的醫療器材展－「德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA）」辦理超過 40 年，為拓展歐洲醫療器材市場的跳板，更是接觸全球醫療器材業界買主的最佳平台。2018 共有來自全球 130 國 6,186 家專業醫療器材廠商參展，歷年有許多臺灣業者自行參展，2018 年約有臺灣參展商達 231 家。

(三)聯合廠商補助：評選優質台灣廠商聯合以台灣形象館合展。本中心保留審核權利。本次參展每家入選廠商優先補助2020印度孟買展。本中心保留審核權利。
2019medica台灣館將位於17館(17/D46)，展區全區採開放式。

二、參加廠商資格：

須為我國政府立案之醫療器材製造商，產品需為台灣製造。

有下列情形之一者，不符申請資格：

(一)屬銀行拒絕往來戶，且企業淨值(股東權益)為負值。

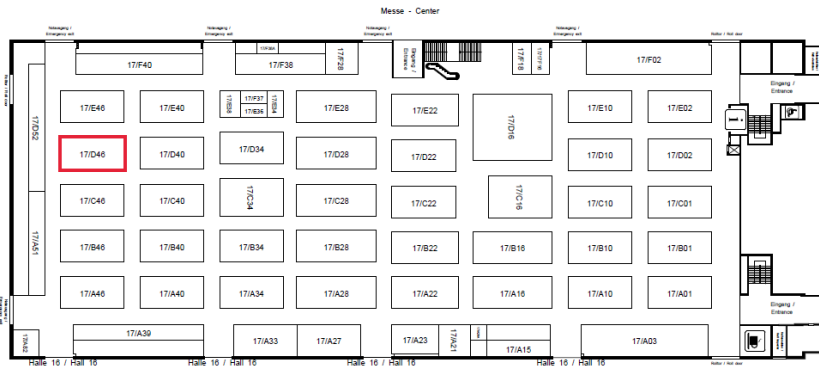
(二)最近5年內曾有執行政府補助計畫之重大違約紀錄。

(三)有因執行政府補助計畫受停權處分且其期間尚未屆滿情事。

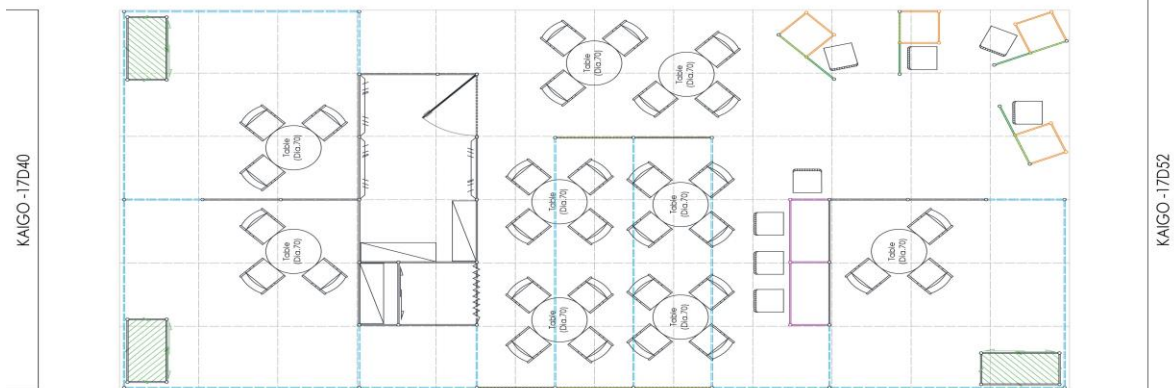
(四)申請企業至收件截止日前有欠繳應納稅捐情事。

(五)至本計畫公告收件截止日前1年內，有受註銷、撤銷或暫停出進口處分紀錄者。

三、台灣館位置(金屬中心團區)：台灣館將位於 17 館(17/D46)



TAITRA -17C46



KAIGO -17E46

展出方式：

1. 以「台灣醫療器材產業聯盟」為展出主軸，整合產品線集體國際行銷。
2. 入選本次補助台灣團區廠商一律採用「開放式裝潢設計」，靈活使用攤位空間，塑造整體行銷聯盟形象。
3. 入選本次補助台灣團區廠商於 108 年年底本計畫結案時，須配合提供該(108)年度外銷出口實績 15 萬美金以上訂單。
4. 攤位位置將於評選會議召開後抽籤選位。

入選廠商負擔部分費用：

■ 費用

9 平方米新台幣 270,000 元整(皆為轉角攤位 +開放式裝潢 2 展證+含稅+含大會目錄基本刊登暨媒體推廣費用 485 歐元)。

展台新台幣 70,000 元整(展台+開放式裝潢+含稅+可共用洽談區、儲藏室+含大會目錄基本刊登暨媒體推廣費用 485 歐元)。**展台廠商展證須自購**

開放式裝潢含：

台灣館整體形象裝潢設計

(含公司招牌、地毯、桌椅、投射燈、插座、展櫃等等，詳設計圖配置)

四、本展將就徵集參展廠商做資格篩選，篩選標準如下：

需請廠商出席簡報審查會議，由報名廠商自行簡報公司簡介供審查委員審查。

1. 需台灣製造商 (請提供-工廠登記證、GMP)
2. 產品具出口競爭力 (**入選廠商於年底結案時需提供 108 年度 15 萬美金以上外銷出口訂單 -INVOICE 等證明**)
3. 產品認證 (請提供-CE、FDA、ISO13485 等證書影本)
4. 公司/產品獲獎實績 (請提供-證書影本、獎盃/獎牌照片)參考條件
5. 創新研發 (請提供-參與政府 研發補助計畫 or 專利證明)參考條件

五、付款方式：

1. 廠商需於公佈入選後，一星期內繳交全額費用，超過繳費期限將由備取廠商依序遞補。
2. **繳交完參展費用後，廠商因個別因素退出參展團時，恕不退還已繳交之參展費用，參展名額將由備取廠商遞補之。**

六、廠商注意事項：

1. 標示 Made in China 之產品不得參加
2. 請入選廠商於組團會議務必派員出席，避免權益受損
3. 廠商入選後因個別因素而非本中心或天然災害，退出時應以書面或 e-mail 正式通知本中心
4. 廠商展品若於海關或參展期間被扣留、沒收、遺失，亦不退費

- 5.參加廠商不得與其他非本團團員共用其攤位，亦不得擅自轉讓攤位
- 6.為維護整體形象，除原配置海報位置外，廠商如須於攤位內張貼宣傳品，請知會本中心
- 7.展覽活動期間內必須在場看顧樣品接洽交易，並協助提供資料以便本中心分析市場及統計推銷成果，其涉及業務機密部分，本中心將予審慎保密
- 8.參加廠商之展品、出版品刊登產品圖文，不得涉及商品仿冒或侵害國內外其他廠商之專利權、商標權及智慧財產權，如涉及仿冒事宜，由廠商自行負擔所有責任，並支付衍生之訴訟仲裁等費用，以及活動主辦國行政或司法裁定之賠償或罰鍰
- 9.攤位位置順序於組團會議中依抽籤決定

七、參團廠商自行負擔費用部份：

- 1.展品包裝報關、出口裝櫃、船運、保險、及在目的地國之通關提貨、內陸運輸及進場、關稅費用及相關手續費用
- 2.超出本中心裝潢所提供之攤位配備費用
- 3.參加廠商代表之食宿、機票、交通、簽證費及行李超重等費用
- 4.活動結束後樣品處理費用
- 5.其他臨時發生，無法以本中心預算容納之費用

八、報名期限：



請填寫完報名表及兩份個資同意書傳真 07-6955627 或 email (jennifer@mail.mirdc.org.tw)
始完成報名參加審查會程序。

實際審查日期以正式 email 審查會通知為準

九、報名聯絡方式

聯絡人：鄭至芳 聯絡信箱：jennifer@mail.mirdc.org.tw 聯繫電話：07-6955298 (分機 259)

十、金屬中心歷屆展會實務

<p>2018 印度清奈醫療展</p>	<p>2018 新加坡 IDEM 展</p>	
		
		
<p>2018 德國 medica</p>	<p>2016 新加坡 IDEM 展</p>	<p>2014 印度新德里展</p>
		
		

Medica 2019 廠商報名資料

廠商名稱	(中文)					
	(英文)					
企業基本資料	負責人姓名		職稱		統一編號	
	聯絡人姓名		職稱		E-mail	
	電話			傳真		
	地址					
	員工人數		人	登記資本額		元
	GMP設廠	<input type="checkbox"/> 有(請檢附證明)	<input type="checkbox"/> 無	公司登記		年 月
	產品名稱(中/英)					
報名攤位 9m2 費用 (攤位+開放式裝潢，含稅)新台幣270,000元整(皆為轉角) 展台 費用新台幣70,000元整(可共用洽談區、儲藏室)。						
一、創新研發實績 (參與政府研發補助計畫or專利申請) <input type="checkbox"/> 是 (請檢附/計畫書封面影本or專利證書影本) <input type="checkbox"/> 否						
二、出口貿易實績 <input type="checkbox"/> 是 (展後請檢附/INVOICE影本) <input type="checkbox"/> 否						
三、產品認證 (CE、FDA、ISO13485) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
四、公司/產品獲獎實績 <input type="checkbox"/> 是 (請檢附/證書影本or獎盃/獎牌照片) <input type="checkbox"/> 否						
報名廠商 公司簽章	敝司已詳閱本徵展通知並同意配合上述參加條件與規定					

欲參加本展覽之廠商，請填寫完報名表及**兩份個資同意書**後傳真 07-6955627

或 email (jennifer@mail.mirdc.org.tw)予我們，以利後續作業。謝謝您！

經濟部工業局

個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書*廠商須填寫親簽用印方受理報名

告知事項：

經濟部工業局（下稱本局）為了執行「醫療器材產業技術輔導與推廣計畫」，將蒐集、處理

及利用您的個人資料（下稱個資），謹先告知下列事項：

- 一、蒐集目的：076 計畫、管制考核與其他研考管理。
- 二、個資類別：C001 辨識個人者、C002 辨識財務者、C003 政府資料中之辨識者、C011 個人描述、C038 職業、C051 學校紀錄、C052 資格或技術、C053 職業團體會員資格、C054 職業專長、C061 現行之受雇情形、C062 僱用經過、C064 工作經驗、C070 工作管理之細節。
- 三、利用期間：至蒐集目的消失為止。
- 四、利用地區：中華民國地區及本局辦事處所在地區。
- 五、利用者：本局及其他與本局有業務往來之公務及非公務機關。
- 六、利用方式：在不違反蒐集目的的前提下，以網際網路、電子郵件、書面、傳真及其他合法方式利用之。
- 七、您得以書面主張下列權利：
 - （一）查詢或請求閱覽。
 - （二）請求製給複製本。
 - （三）請求補充或更正。
 - （四）請求停止蒐集、處理或利用。
 - （五）請求刪除。

若有上述需求，請與承辦人員鄭至芳(電話：07-6955298#259；E-mail：jennifer@mail.mirdc.org.tw)聯繫，本局將依法進行回覆。

八、您若不簽署本告知暨同意書，本局將無法提供您特定目的範圍內之相關服務。

九、對本局所持有您的個資，本局會按照政府相關法規保密並予以妥善保管。

本人已閱讀並瞭解上述告知事項，並同意工業局在符合上述告知事項範圍內，蒐集、處理及利用本人的個資。

簽名：

中華民國 年 月 日

財團法人金屬工業研究發展中心

個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書*廠商須填寫親簽用印方受理報名

告知事項：

本中心因受 工業局 委託執行本活動，將蒐集、處理及利用您的個人資料（下稱個資），謹先告知下列事項：

一、蒐集目的：076 計畫、管制考核與其他研考管理。

二、個資類別：C001 辨識個人者、C002 辨識財務者、C003 政府資料中之辨識者、C011 個人描述、C038 職業、C051 校紀錄、C052 資格或技術、C053 職業團體會員資格、C054 職業專長、C061 現行之受雇情形、C062 僱用經過、C064 工作經驗、C070 工作管理之細節。

三、利用期間：至蒐集目的消失為止。

四、利用地區：中華民國地區及本院駐點及辦事處所在地區。

五、利用者：本中心及其他與本中心有業務往來之公務及非公務機關。

六、利用方式：在不違反蒐集目的的前提下，以網際網路、電子郵件、書面、傳真及其他合法方式利用之。

七、您得以書面主張下列權利：

（一）查詢或請求閱覽。

（二）請求製給複製本。

（三）請求補充或更正。

（四）請求停止蒐集、處理或利用。

（五）請求刪除。

若有上述需求，請與本活動之承辦人員鄭至芳聯繫，本中心將依法進行回覆。

八、若未提供正確個資，本中心將無法提供您特定目的範圍內之相關服務。

九、對本中心所持有您的個資，本中心會按照政府相關法規保密並予以妥善保管。

財團法人金屬工業研究發展中心

本人已閱讀並瞭解上述告知事項，並同意金工中心在符合上述告知事項範圍內，蒐集、處理及利用本人的個資。

簽名：

中華民國 年 月 日